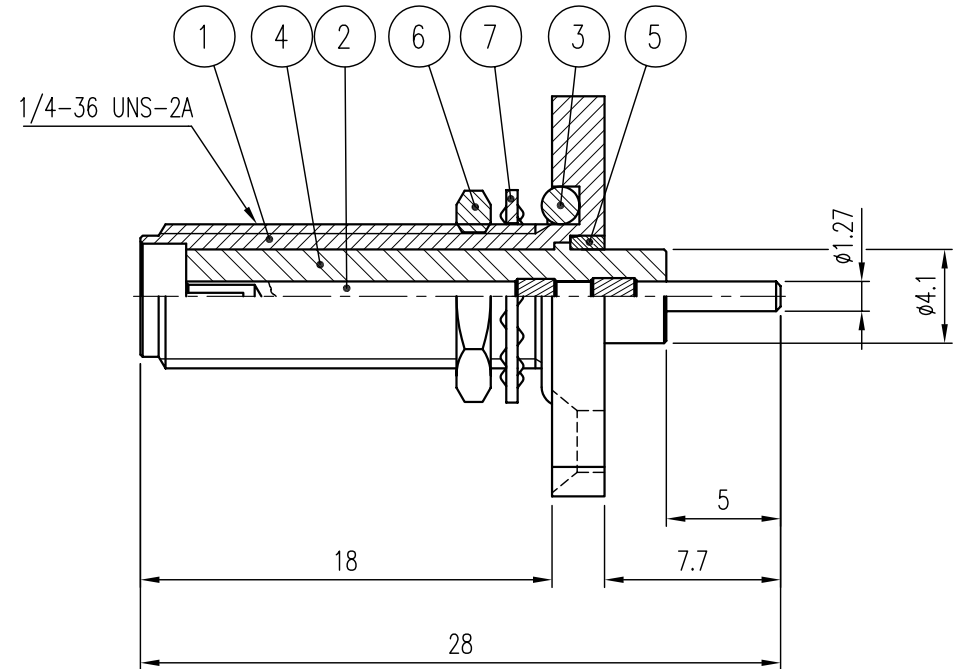
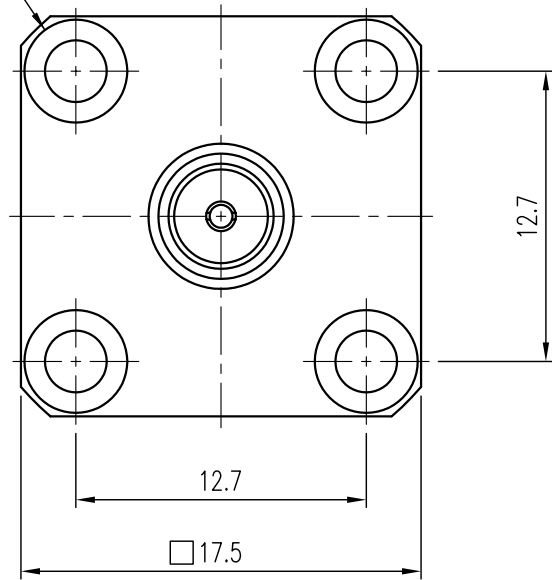


가공	1	2	3	4	수 정 내 용				
ST					부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)					1	기타(설면처리)No.200803-0020 (나사 고정부 4곳 치수 변경 $\phi 2.3 \rightarrow \phi 2.7$)	김은희	윤상진	2008. 3. 24.
ST(개선)									

4- $\phi 2.3$ $\phi 2.7$ DRILL
C'SINK $\phi 4.5$



7	WASHER	1	MBsBD	SUCO Plate	DWA00005-5/2
6	NUT	1	MBsBD	SUCO Plate	DNT00025-5/2 (N2009)
5	고정 링	1	MBsBD	SUCO Plate	DCV00036-5/2
4	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN01085-N/1
3	GASKET	1	SILICONE RUB	Black	DGK00023-N/1 (G2004)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01349-5/1
1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate	DBD01550-5/2 DBD01888-5/1

주 기

1. 회전 토크 7Kgf 이상 일 것.

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2008. 1. 14.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
	검도						
재질	제도				도명	SMA50-BJ-4H-R VER.1	
열처리	작성부서						
보호피막처리	연 구 소			A4	도번	CN01186-7/2	
	척도 3/1	단위 mm	중량				

A4

도번 CN01186-7/2